

Technisches Merkblatt des Produkts

AG Copper

Wärmeleitpaste auf Kupferbasis zum Füllen von Prozessor-Radiatorverbindungen bestimmt, um die Kühlung zu verbessern.

Wärmeleitfähigkeit ~ 3,1 W/mK.

Anwendung:

Füllen von Prozessor-Radiatorverbindungen,
nicht für Aluminiumradiatoren bestimmt,
Leitet kein Strom.

Physikochemische Eigenschaften:

Parameter	Einheit	Ergebnis
Aussehen	-	Paste, Kupfer
Geruch	-	geruchlos
Schmelzpunkt	°C	-50
Flammpunkt	°C	350
Dichte	g/cm ³	2,9
Arbeitstemperaturbereich	°C	-50 ~ 250

Verpackungen:

Volumen	Art der verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
1,5 ml	Spritze	5	ART.AGT-060
14 ml	Spritze	2	ART.AGT-061

Lagerung:

An einem gut belüfteten, kühlen, trockenen Ort lagern. Behälter, falls diese nicht gebraucht werden, dicht verschlossen lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind mit dem aktuellen Stand unseres Wissens übereinstimmig. Diese beschreiben typische Eigenschaften und Anwendungen des Erzeugnisses. Die Angelegenheit des Benutzers ist jedoch die Untersuchung der Eignung dieses Produkts für bestimmte Anwendungen. Wir können keine Verantwortung für die erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Verwendungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen.